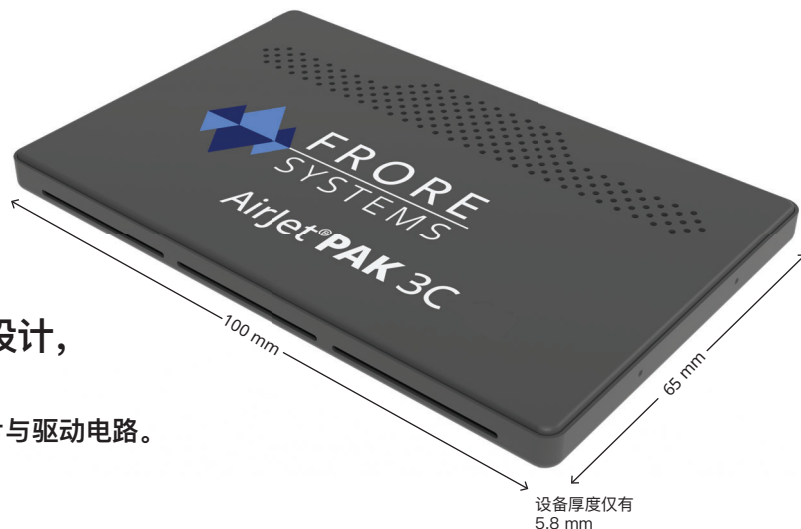




AirJet® PAK 3C

专为配合英伟达 Jetson Orin Nano/NX 而设计，以释放AI性能。

- 完全独立的即插即用散热解决方案，内含多个 AirJet 芯片与驱动电路。可直接安装在英伟达 Jetson Orin Nano/NX 模块上。
- 自主运行。
- 轻薄、静音、无振动，具备防尘防水功能。
- 在英伟达 Jetson 平台上，支持高达 80 TOPS 的算力。
- 在环境温度 25°C、结温 115°C 的条件下，净散热量可达 24 瓦。



在计算领域，热量是最大的瓶颈，而散热则是如今计算领域中唯一仍在沿用的属于上个世纪的技术。为了满足人工智能所需要的大规模处理，要大幅改进散热技术的需求正在迅速增长。此外，据预测，到 2030 年，对边缘人工智能的需求预计将增长超过 300%，并且短期内这种需求并不会减缓。

AirJet PAK 是全球首款面向边缘人工智能的固态主动散热解决方案，它采用了革命性的 AirJet 主动散热芯片。AirJet PAK 3C 是一个完全独立的主动散热模组。

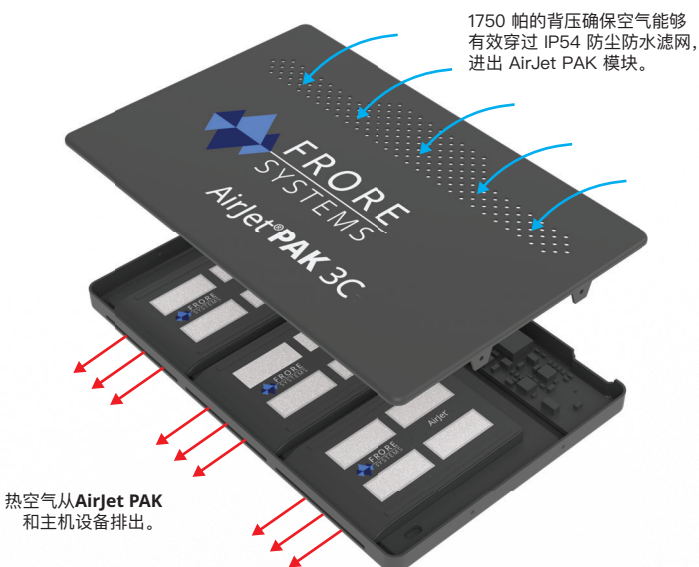
强劲散热能力 —— 当集成到散热器温度为 80°C 的计算平台中时，AirJet PAK 3C 能以 26 分贝的静音状态净散出 24 瓦热量，同时最大功率消耗仅 4 瓦。在紧凑型边缘人工智能设备中，其散热表现优于风扇。

释放 AI 性能 —— AirJet PAK 3C 厚度仅为 5.8 毫米，专为 NVIDIA Jetson Orin Nano、NX 以及 AGX Orin 模块而设计。这种超薄设计为制造商开辟了新的可能性，能够满足客户对于设备更紧凑、静音、无振动、防尘且防水的同时，实现更高性能的需求。

AirJet PAK	NVIDIA Jetson	TOPS	Power
AirJet PAK 3C	Orin NX 16GB (@ 25°C ambient, Tj 95°C)	80	20 W
2x AirJet PAK 3C	Orin NX 16GB (@ 25°C ambient, Tj 95°C)	157	40 W

每个AirJet PAK 3C 模组均内置3块 AirJet 芯片 – 全球首款固态主动式散热芯片。

指标	AirJet® PAK 3C
总净散热量 (内部温度 115°C, 环境温度 25°C 时)	24 W
最大噪音 (距离 50 厘米处)	26 dBA
最大功耗	4 W
背压	1750 Pa
尺寸 (宽 × 长 × 厚)	100 x 65 x 5.8 mm
重量	70 g



AirJet® PAK 3C

持续稳定的性能与可靠性

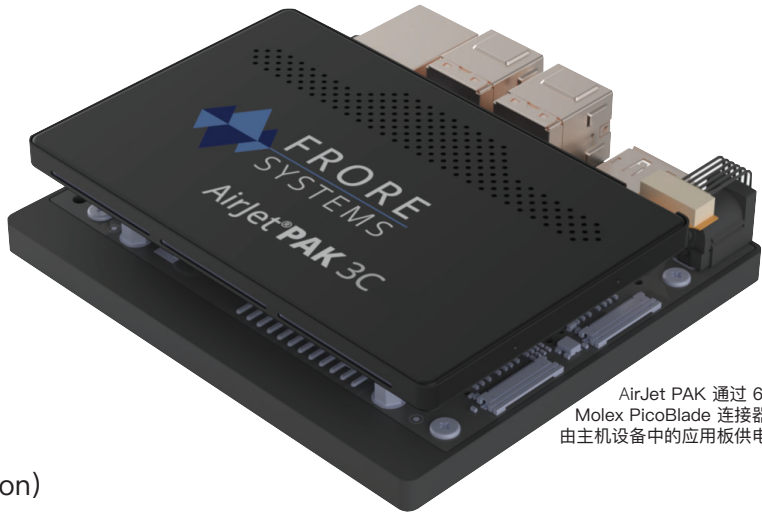
AirJet PAK 可产生 1750 帕的背压，即使通风口被 IP54 防尘防水过滤器覆盖，也能确保空气有效进出模块。结合 AirJet PAK 的智能自清洁功能，进一步提升了可靠性，确保其散热性能持续稳定，从而使具备防尘功能的主机设备也能保持高性能运行。

AirJet PAK 通过自主驱动，运用热感技术（Thermoception）独立感知周围温度。这一创新技术让 AirJet PAK 无需依赖主机设备内的温度传感器，就能优化自身性能，实现高效散热。AirJet PAK 只需从主机设备获取额定电源，就能助力处理器发挥卓越性能。

在如今的设备中，决定性能的往往不只是处理器的先进程度，散热解决方案的能力同样至关重要。

得益于 AirJet PAK 3C，紧凑型边缘人工智能电子设备如今终于能够兑现尖端人工智能技术的承诺。实现更多。

AirJet® PAK 模块在主机设备内部的横截面。



AirJet PAK 通过 6 针 Molex PicoBlade 连接器，由主机设备中的应用板供电。

专为 NVIDIA Jetson Orin Nano 和 NX 模块优化，实现无缝集成。

AirJet PAK 3C 随环境温度而变化的散热性能

